## Índice general

Ι	Sistemas Microelectromecánicos (MEMS)	1
1.	Definición y breve historia de los MEMS         1.1. Aplicaciones y mercados         1.2. Publicaciones periódicas, conferencias y sitios electrónicos	<b>3</b> 9 13
2.	Tecnología para la fabricación de MEMS         2.1. Materiales para la fabricación de MEMS         2.1.1. Enlaces interatómicos         2.1.2. Estructura de los materiales         2.1.2. Diseño de Mems asistido por computadora         2.2.1. Programas de diseño y simulación         2.2.2. Creación de máscaras para la fabricación de MEMS	17 17 17 18 18 20 48

## II Principios físicos del funcionamiento de los Sistemas Microelectromecánicos 65

3.	Teo	ría de elasticidad	67
	3.1.	Esfuerzo y deformación unitaria	67
		3.1.1. Esfuerzo	67
		3.1.2. Deformación unitaria	69
		3.1.3. Ley de Hooke	73
		3.1.4. Relaciones generales entre esfuerzo y deformación unitaria	74
	3.2.	Esfuerzo y deformación unitaria en vigas	77
		3.2.1. Esfuerzo y deformación en una viga flexionada	77
		3.2.2. Momento de flexión y momento de inercia	79
		3.2.3. Desplazamiento de vigas bajo peso	82
		3.2.4. Flexión por deformación residual de vigas compuestas	89
		3.2.5. Desplazamiento angular de vigas sujetas a torsión	94
	3.3.	Método de la energía para el análisis de la frecuencia de oscilación	97
		3.3.1. Sistema masa-resorte	97
		3.3.2. Método de Rayleigh-Ritz	100
		3.3.3. Frecuencias de oscilación de una viga	103
	3.4.	Modos de oscilación y flexión de una viga	107
		3.4.1. Ecuación diferencial para la oscilación libre de una viga	107
		3.4.2. Frecuencias de oscilación de una viga doblemente anclada	109
		3.4.3. Oscilación bajo la acción de una fuerza axial	112
		3.4.4. Flexión de una viga doblemente anclada	115
	3.5.	Vibraciones forzadas y amortiguadas	118
		3.5.1. Fuerza de amortiguamiento	118
		3.5.2. Vibraciones con amortiguamiento	119
		3.5.3. Oscilación provocada por una fuerza	123

3.5.4.	Resonancia y factor de calidad	126
3.5.5.	Oscilación provocada por una vibración	129

## 4. Amortiguamiento por efecto del aire

 $\mathbf{133}$ 

	4.1.	Efecto de arrastre de	un fluido	133
		4.1.1. Viscosidad de	un fluido	133
		4.1.2. Flujo viscoso d	de un fluido	136
		4.1.3. Amortiguamie	nto por la fuerza de arrastre	140
		4.1.4. Efectos del am	nortiguamiento debido al aire sobre la dinámica de los Microsistemas	141
	4.2.	Amortiguamiento por	compresión de una película de aire	142
		4.2.1. Ecuación de R	Leynolds para amortiguamiento por presión sobre una película de aire	142
		4.2.2. Placa rectange	ılar larga	147
		4.2.3. Placa rectange	ılar	148
		4.2.4. Placas circular	res y anillos	152
		4.2.5. Placa perforad	la, infinita y muy delgada	155
		4.2.6. Amortiguamie	ento en vigas con movimiento oscilatorio	157
		4.2.7. Efectos de un	coeficiente de presión pequeño	161
	4.3.	Amortiguamiento de j	placas gruesas perforadas	163
		4.3.1. Ecuación mod	ificada de Reynolds para placas perforadas	163
		4.3.2. Placa perforad	la larga v rectangular	165
		4.3.3. Aproximación	del área efectiva de amortiguamiento	168
	4.4.	Amortiguamiento por	deslizamiento de superficies sobre una película de aire	169
		4.4.1. Ecuaciones bás	sicas para el amortiguamiento por deslizamiento de superficies sobre una	
		película de air	e	169
		4.4.2. Modelo del flu	jo de Couette	172
		4.4.3. Modelo del flu	jo de Stokes	174
		4.4.4. Amortiguamie	nto por efecto del aire para un resonador con actuador electrostático	
		lateral en form	na de peine	176
	4.5.	Amortiguamiento en a	aire enrarecido	178
		4.5.1. Viscosidad efe	ctiva del aire enrarecido	178
		4.5.2. Modelo de Chi	ristian para amortiguamiento provocado por aire enrarecido	180
		4.5.3. Modelo de tran	nsferencia de energía para amortiguamiento por presión sobre una pelícu-	
		la de aire		182
		4.5.4. Amortiguamie	ento en alto vacío	188
F	Act	unaión alactrostático		01
J.	ACU 5 1	Fuorzas oloctrostática	a	101
	0.1.	5.1.1 Fuerza normal		101
		5.1.2 Fuerza tangon	ر	102
		5.1.3 Efectos on los	hordos	102
	59	Actuadores mecánicos	s impulsados por fuerzas electrostáticas	105
	0.2.	5.2.1 Actuador do p	lacas paralolas	105
		5.2.1. Actuador de p	nacas paraicias	200
		5.2.2. Actuador elect	trostático latoral on forma do poino	200
	59	Voltaio alterno y casa	long aplicados a los actuadores electrostáticos	204 206
	J.J.	5.3.1 Voltajo alterno	nones apricados a los actuadores electrostaticos	200 206
		5.3.9 Efecto do reco	rta nogativa v fracuancia da vibración	200 910
		5.3.3 Actuación ma	diante voltaie de tipe alterno	21U 919
		J.J.J. ACTUACION MEC		4 <b>1</b> 4

6.	Reg	istro d	le variaciones en sensores capacitivos	<b>215</b>
	6.1.	Esque	mas de medición de variaciones en la capacitancia	215
		6.1.1.	Mediciones a través de un voltaje directo de polarización	219
		6.1.2.	Medición mediante arreglos de diodos	222
		6.1.3.	Medición mediante doble excitación	225
		6.1.4.	Medición mediante balance de fuerzas electrostáticas	227
		6.1.5.	Medición mediante conmutación de capacitores	230
		6.1.6.	Medición de la frecuencia	232
	6.2.	Efecto	s de la excitación eléctrica en sistemas que reciben una aceleración c te. $\ldots$ . $\ldots$ .	234
		6.2.1.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor simple	234
		6.2.2.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor doble	238
		6.2.3.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor configurado para el balanceo de fuerza	s241
	6.3.	Efecto	s de la excitación en sistemas que reciben acel. con forma de escalón	245
		6.3.1.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor simple	245
		6.3.2.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor doble	248
		6.3.3.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor configurado para el balanceo de fuerza	s249
	6.4.	Efecto	s de la excitación en sistemas que reciben una acel. con forma de pulso $\ldots \ldots \ldots \ldots$	251
		6.4.1.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor simple	251
		6.4.2.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor doble	252
		6.4.3.	Efectos de la excitación eléctrica en un capacitor configurado para el balanceo de fuerza	ıs253
II	ΙI	Diseño	o de sensores inerciales micromaquinados	255

7.	Ant	ecedentes	257
	7.1.	Sensores inerciales	257
	7.2.	Aplicaciones	262
8.	Con	ceptos básicos de los acelerómetros	267
	8.1.	Descripción general	267
	8.2.	Configuración geométrica de un acelerómetro micromaquinado	270
		8.2.1. Masa móvil	270
		8.2.2. Suspensión	271
		8.2.3. Amortiguador	284
		8.2.4. Transductor mecánico-eléctrico	287
		8.2.5. Factor de calidad	288
9.	Dise	eño de un acelerómetro micromaquinado en el proceso PolyMumps	289
	9.1.	Propuesta de los parámetros de diseño	289
	9.2.	Simulación mediante ecuaciones diferenciales de parámetros concentrados	309
		9.2.1. Acelerómetro de 600 x 1200 $[\mu m^2]$ con suspensión de caja	318
		9.2.2. Acelerómetro de 600 x 1200 $[\mu m^2]$ con suspensión sagital $\dots \dots \dots \dots \dots \dots$	322
		9.2.3. Acelerómetro de 960 x 1200 $[\mu m^2]$ con suspensión de caja	327
		9.2.4. Acelerómetro de 960 x 1200 $[\mu m^2]$ con suspensión sagital $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	331
		9.2.5. Acelerómetro de 1200 x 360 $[\mu m^2]$ con suspensión de caja	336
		9.2.6. Acelerómetro de 1200 x 360 $[\mu m^2]$ con suspensión sagital $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	340
		9.2.7. Acelerómetro de 1200 x 480 $[\mu m^2]$ con suspensión de caja	345
		9.2.8. Acelerómetro de 1200 x 480 $[\mu m^2]$ con suspensión sagital $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	349
	9.3.	Máscara final	354
		9.3.1. Acelerómetro de 600 × 1200 $[\mu m^2]$ con suspensión de caja	359
		9.3.2. Acelerómetro de $600 \times 1200 \ [\mu m^2]$ con suspensión sagital	360
		9.3.3. Acelerómetro de 960 × 1200 $[\mu m^2]$ con suspensión de caja	361
		9.3.4. Acelerómetro de 960 × 1200 $[\mu m^2]$ con suspensión sagital	362
		9.3.5. Acelerómetro de 1200 × 360 $[\mu m^2]$ con suspensión de caja	362

9.3.6. Acelerómetro de $1200 \times 360 \ [\mu m^2]$ con suspensión sagital	$\frac{363}{363}$			
9.3.8. Acelerómetro de 1200 × 480 $[\mu m^2]$ con suspensión sagital	364			
9.3.9. Verificación general automática de las reglas de diseño y aproximación de la geometría	364			
9.3.10. Formación del dado final	364			
9.4. Conclusiones y trabajo futuro	365			
A. Apéndice 1. Constantes físicas.				
371 Bibliografía				

## Índice de figuras

1.1.	La Ley de Moore expresa el incremento de la densidad de transistores por unidad de superficie en la fabricación microelectrónica a lo largo de los últimos 45 años	7
2.1.	Configuración general de un acelerómetro micromaquinado.	22
2.2.	Modelo en Simulink del dispositivo mecánico de registro del acelerómetro micromaquinado, el	
	cual es un sistema masa-resorte-amortiguador.	22
2.3.	Modelo en Simulink del acelerómetro completo. El modelo incluye la dinámica del sistema masa-resorte-amortiguador, el bloque de conversión de desplazamiento a capacitancia y el	
	arreglo de realimentación.	23
2.4.	Modelo a nivel de sistema en Orcad PSpice de un acelerómetro micromaquinado con un	
	controlador PID en lazo cerrado.	25
2.5.	L-Edit es el editor de máscaras de Mems Pro de la empresa gala MemsCap	26
2.6.	Modelo tridimensional de un motor electrostático diseñado en MEMSPro	26
2.7.	Simulación en T-Spice de la respuesta en el tiempo de un acelerómetro micromaquinado	27
2.8.	Diseño geométrico de un motor electrostático exportado hacia Ansys desde MemsPro para su	
•	simulación.	28
2.9.	Diagrama de un acelerómetro con vigas voladas como resortes, masa móvil y sensores capaci-	•
	tivos capturado en S-Edit.	28
2.10	. Flujo de diseño en MemsPro.	29
2.11	. El diseno de las máscaras bidimensionales y la definición de los pasos del proceso de fabricación	0.1
0.10	en Designer es la base del trabajo en Coventor Ware.	31
2.12	. Modelado de un microacelerometro en Coventor Ware. A la izquierda, modelo a nivel de sistema	90
0 19	en Architect. A la derecha, modelo geometrico tridimensional en Designer	32
2.13	. Particionamiento (maliado) de una placa suspendida correspondiente a un capacitor variable	วก
914	Apólicies del desplayamiente en un migrainterrunter electrostótico en Apolyger de CoventerWare	ე∠ ვვ
2.14 2.15	. CoventorWare puede simular Sistemas Microoptoelectromecánicos (MOEMS) como un mi-	აა
2.10	croespejo.	33
2.16	Máscara creada con IntelliMask de IntelliSuite.	34
2.17	. De la máscara al modelo tridimensional al mallado para la simulación multifísica	35
2.18	. Modelado tridimensional y mallado de un acelerómetro en IntelliFab de Intellisuite	35
2.19	. Simulación electromecánica de un sensor de presión piezoresistivo en IntelliSuite.	36
2.20	. Modelado del fluido dentro de una boquilla de tinta con IntelliSuite.	37
2.21	. Simulación con AnisE del micromaquinado en volumen de un acelerómetro fabricado en una	
	oblea tipo $[100]$	38
2.22	. Procedimiento típico en Ansys Multiphysics	39
2.23	. Actuador electrotérmico conocido como HotArm. Al circular una corriente eléctrica entre los	
	dos cojinetes se disipa energía en forma de calor (efecto Joule) lo que incrementa la temper-	
	atura del material y lo deforma. El efecto obtenido es un cabece o hacia la izquierda. $\ldots$ . $\ldots$	40
2.24	. Imagen de un actuador electrotérmico fabricado en el proceso PolyMumps (Simon Fraser	
	University, 2003). El actuador tiene una longitud de 200 $\mu{\rm m}$ y es capaz de alcanzar un de-	
	splazamiento máximo de 10 $\mu$ m.	41

2.25.	Mallado de la placa y de las vigas de torsión del microespejo. La placa funciona como electrodo y superficie reflejante giratoria del dispositivo.	42
2.26	Mallado de la placa del microespeio, del sustrato y de la masa de aire que rodea al Microsistema	42
2.20. 2.27.	Visualización de los contornos de voltaje para el microespejo gracias a las herramientas de	12
	post-procesamiento que Ansys proporciona a los disenadores	42
2.28.	Visualización de la rotación y aproximación entre placas del Sistema Microelectromecánico.	43
2.29.	Visualización con Ansys de los esfuerzos en las vigas de torsión del microespejo	43
2.30.	Estructura modular de ComSol Multiphysics. Entre los módulos que ofrece se encuentra uno especialmente orientado al modelado y simulación de Sistemas Microelectromecánicos: además.	
	ComSol Multiphysics puede intercambiar información con Matlab y Simulink en formatos	11
0.91	Pagultado de la gimulación del estuador electrostótico con forme de paine. La imagen muestre	44
2.91.	desplazamiento e intensidad de campo eléctrico	45
2.32.	Visualización tridimensional del desplazamiento del giroscopio afectado por el amortiguamien- to debido a la compresión del aire atrapado entre el sustrato y la masa suspendida.	45
2.33.	Diagrama que representa las distintas etapas necesarias para la simulación de Microsistemas	
	con Algor	47
2.34.	Visualización de esfuerzos obtenida mediante la simulación electromecánica de una microbom-	
	ba piezoeléctrica usada en aplicaciones biomédicas tales como: la creación de dosificadores	
	automáticos de medicamentos para pacientes con diábetes o bajo tratamiento de quimioterapia.	47
2.35.	Análisis de las fuerzas electrostáticas generadas cuando se aplica un voltaje al actuador elec-	
	trostático de peine con forma radial.	48
2.36.	Capacitor variable simulado con Abaqus. En la gráfica se visualiza el desplazamiento de la	
	placa y de las vigas que la sostienen con lo cual varía la capacitancia del dispositivo. Los varac-	
	tors son parte de los Sistemas Microelectromecánicos para Radio Frecuncia. Sus aplicaciones	
	más comunes están en los controladores de frecuencia y los generadores de armónicos	49
2.37.	Interruptor micromaquinado simulado con Abaqus. En la imagen se aprecia el desplazamiento	
	de la viga volado que cierra el circuito entre los dos cojinetes inferiores. La viga volada se	
	flexiona por efecto de la fuerza electrostática presente entre ella y el cojinete inferior más	
	grande.	49
2.38.	Ciclo del proceso de micromaquinado de superficie	50
2.39.	Ejemplo de aproximación mediante un polígono cerrado frente a la entidad geométrica original.	51
2.40.	Pantalla del ambiente de diseño MemsPro. La barra de herramientas del proceso se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla. El proceso que muestra es PolyMumps de la empresa	
	MemsCap.	51
2.41.	Capas de material estructural y de sacrificio del proceso de fabricación de Sistemas Micro-	
	electromecánicos PolyMumps. También se muestra el trabajo de socavado realizado sobre la	
	primera capa de sacrificio (primer óxido) llamado Dimples (postes)	52
2.42.	La periferia de la masa y los agujeros de liberación son descritos por una secuencia continua	
	de segmentos de línea para formar polígonos cerrados en una sola capa	55
2.43.	La masa es dibujada en una capa y los agujeros en otra, así, la descripción se logra en dos	
	capas separadas.	55
2.44.	Cortes seccionales de varios Sistemas Microelectromecánicos: a) actuador electrotérmico, b)	
	resonador, c) placa levadiza y d) capacitor variable	56
2.45.	Simulación de capas de polisilicio ancladas entre sí	57
2.46.	Visualización del corte seccional de un poste creado en MemsPro. Intencionalmente se violan	
	las reglas de diseño para compactar el perfil del poste.	57
2.47.	Cojinete de contacto. Elemento indispensable en el diseño de Sistemas Microelectromecánicos	
	para ingresar y extraer señales eléctricas mediante puntas de prueba o conductores soldados.	58
2.48.	Anillo rotacional. Elemento básico para la creación de engranes, motores electrostáticos, levas	-
0.40	y palancas.	59
2.49.	Viga volada. Elemento básico para la creación de resortes, masas suspendidas, actuadores	00
	electrotermicos, actuadores electrostaticos y microinterruptores, entre otros	00

2.50	. Bisagra. Elemento que permite a una placa de polisilicio girar alrededor de un eje paralelo a	61
2.51	Revisión automática de las reglas de diseño sobre una máscara creada con L-Edit. La ventana	01
	de revisión de errores señala cada una de las violaciones y conduce al diseñador hasta la sección	<u></u>
0 50	de la máscara en donde se encuentra la falla.	63
2.32	do poine b) suspensión en forma de cangreio, c) actuador electrostatico rotacional en forma	
	electrostático	64
2.53	. Motor electrostático hecho completamente a partir de celdas estándar disponibles en MemsPro	. 64
3.1.	Componentes del tensor de esfuerzos	68
3.2.	Deformación de un material unidimensional	69
3.3.	Deformación en un material tridimensional	70
3.4.	Deformación angular debido a esfuerzos cortantes.	72
3.5.	Un elemento con forma de paralelepipedo sometido a un esfuerzo normal	73
3.6.	Sección elemental de una viga.	77
3.7.	Combado de una viga bajo la acción de un momento de flexión	78
3.8.	Las fuerzas provocan un momento de flexión.	80
3.9. 2.10	Vire viele de con concentre de con contracte de contract	81
3.10	Viga volada con carga distribuida	00 84
3.11	Viga volada con carga distribuida	86
3.12	El dibujo esquemático de una estructura formada por dos vigas voladas sosteniendo una masa	87
3.14	. El albujo esquentario de una estructura formada por ass vigas voladas secontendo una masa . Flexión del par de vigas voladas que sostienen una masa por efecto del peso	. 01 87
3.15	Distribución del esfuerzo sobre la superficie de la viga.	88
3.16	. Viga compuesta por dos capas: óxido de silicio $(SiO_2)$ y silicio $(Si)$	90
3.17	. Viga compuesta por $n$ capas	93
3.18	. Sección transversal de la barra de torsión rectangular.	96
3.19	. Microestructura con barras de torsión. A la izquierda una perspectiva del dispositivo. A la	
	derecha una vista seccional.	96
3.20	. Modelo masa-resorte	98
3.21	Análisis de la energía potencial en una viga	101
3.22	. Funcion de forma aproximada para el primer modo superior de vibracion.	107
3.23	Evergas y momentos actuando sobre la sección de una viga en movimiento oscilatorio	108
3.24	Flevión (combado) de una viga doblemente anclada	112
3.20	Modelo simplificado de un sistema oscilatorio con amortiguamiento	119
3.27	Grafica con las atenuaciones de amplitud de oscilación en sistemas con diferentes coeficientes	110
	de amortiguamiento. $\ldots$	121
3.28	. Respuesta a una fuerza con forma de escalón para diferentes coeficientes de amortiguamiento.	123
3.29	. Relaciones entre la amplitud y la frecuencia para diferentes coeficientes de amortiguamiento.	125
3.30	. Corrimiento de fase de vibraciones forzadas para diferentes coeficientes de amortiguamiento	126
3.31	. Oscilación inducida por una vibración mecánica.	130
4.1.	Mecanismo de voscosidad en líquidos.	134
4.2.	Mecanismo de viscosidad en un gas.	134
4.3.	Esfuerzos cortantes sobre la superficie de un elemento cúbico en un líquido. $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$	136
4.4.	Flujo de un fluido en una tubería muy larga.	137
4.5.	Presión ejercida por un movimiento de compresión sobre el aire contenido entre dos placas.	142
4.6.	Flujo de masa dentro y fuera de un elemento unitario. (a) una columna elemental, (b) las	4.40
4 7	tasas de flujo	143
4.1. 10	Compresión de un gas debida a la acción de un pistón	140
4.0. 1 0	Distribución de la presión bajo una larga placa roctangular.	141
ч.Э.	Distribution de la presión bajo una larga placa rectaliguiat	140

<ol> <li>4.10.</li> <li>4.11.</li> <li>4.12.</li> <li>4.13.</li> <li>4.14</li> </ol>	Placa rectangular con dimensiones de ancho y largo comparables	149 152 1.153 1.154
1.1 1.	(b) arregio hexagonal.	155
4.15.	La dependencia del factor k respecto de $\beta$ .	157
4.16.	Modelo de una cadena de discos para el amortiguamiento por efecto del aire en una viga (vista	
	superior).	159
4.17.	Esquema de la estructura de una placa perforada. (a) vista superior y (b) vista de la sección transversal.	164
4.18.	Geometría de una larga placa rectangular perforada $(b \gg a)$ . En la figura no se muestran los	
	agujeros	166
4.19.	Dependencia de la distribución normalizada de presión respecto de $a/l$	167
4.20.	Distribución de la presión (normalizada) para una placa rectangular cuyo ancho, $a$ , es diez veces mayor que la longitud de atenuación: $l$ .	168
4.21.	Aproximación de la distribución de la presión para una placa rectangular con $a$ diez veces mayor que $l$	169
4.22.	Amortiguamiento por deslizamiento sobre una delgada película de aire. (a) esquema de la estructura y (b) modelo simplificado	170
4.23.	Decaimiento efectivo de la distancia, $\delta$ , como función de la frecuencia	172
4.24.	Placa que oscila lateralmente sobre el sustrato.	173
4.25.	Esquema de un resonador basado en un actuador electrostático en forma de peine. $\ldots$ .	176
4.26.	Colisiones frontales de la placa oscilante con las moléculas de gas	180
4.27.	La velocidades de la placa y de una molécula. (a) antes de una colisión y (b) después de una	100
1 90	Collsión.	183
4.28.	Compresion de aire en un ambiente de baja presion (enrarecimiento de gases)	185
4.29.	Dependencia del factor de candad de la presión del arre	100
<ul><li>6.1.</li><li>6.2.</li><li>6.3.</li></ul>	Ejemplos de actuadores de placas paralelas. (a) Microrresonador con peine electrostático para movimiento lateral (consignado en The MEMS Handbook: design and fabrication, editado por Mohamed Gad-el-Hak, CRC Press, 2006). (b) Giroscopio con actuadores de placas parale- las dispuestos en pila vertical (consignado en Robust Micromachined Vibratory Giroscopes, Cenk Acar, University of California, 2004). (c) Scanner bidimensional con peines electrostáti- cos verticales (consignado en http://www.stanford.edu/~wibool/research.html, 2009). (d) Mi- cromotor electrostático (consignado en Comprehensive Microsystems editado por Yogesh B. Gianchandani, Elsevier, 2008)	216 217
<u> </u>	Elsevier, 2008)	218
6.4.	Esquema de medición de variaciones de capacitancia a través de un voltaje directo de polar-	010
GF	IZACION.	219
0.J. 6.6	Circuito basado en diodos rectificadores (puento de Wheatstone) para el registro de variaciones	220
0.0.	en la capacitancia.	222

6.7. 6.8.	Puente de Wheatstone para registrar cambios en un capacitor variable diferencial Puente de Wheatstone con carga externa	$224 \\ 224$
6.9.	Circuito para el registro de variaciones en la capacitancia mediante la aplicación de dos señales sinusoidales.	226
6.10.	Circuito para el registro de variaciones en la capacitancia mediante la aplicación de dos señales sinusoidales y realimentación.	227
6.11.	Técnica para registro de variaciones en la capacitancia y balance de fuerzas electrostáticas presentes en el sensor	221
6.12.	Diagrama del circuito para el registro de variaciones en la capacitancia a través de conmutación de capacitores	220
6.13.	Diagrama del circuito de conmutación de capacitores para registrar variaciones en un capacitor variable diferencial.	231
6.14. 6.15.	Diagrama de un puente autobalanceado para medir un capacitor variable diferencial Diagrama con un oscilador de Schmitt para medir cambios en la frecuencia de oscilación de un circuito	232 233
6.16.	Variante en el uso de un oscilador de Schmitt para el registro de cambios en la frecuencia de oscilación de un circuito	234
6.17. 6.18.	Esquema con la estructura de un dispositivo capacitivo simple	235
6.19.	Les de contaje $(p)$ en un capacitor simple	$\frac{237}{238}$
6.20.	Grafica de la relación entre la aceleración máxima $(f)$ y voltaje $(p)$ para las configuraciones	239
6.22	de capacitor simple y doble	240
6.23.	balanceo de fuerzas eléctricas	241
6.24.	tintos valores de voltaje de realimentación ( $\beta$ )	243
6.25.	tintos valores de voltaje de realimentación $(\beta)$	244 246
6.26.	Dependencia de la aceleración máxima $(q_c)$ respecto del voltaje $(p)$ para una aceleración constante y una aceleración con forma de escalón	240
6.27.	Esquema de la estructura básica de un sensor capacitivo diferencial (doble) sometido a una aceleración con forma de escalón.	248
6.28.	Dependencia de la aceleración crítica $(q_c)$ respecto del voltaje de alimentación $(p)$ para dis- tintos arreglos en los capacitores y aceleración con forma de escalón.	249
6.29.	Esquema de la estructura básica de un sensor capacitivo diferencial (doble) con realimentación para el balanceo de fuerzas sometido a una aceleración con forma de escalón.	250
6.30.	Dependencia de $f(p)$ respecto de $p$ para configuraciones en el capacitor variable con un sólo lado, diferencial y diferencial con realimentación	252
7.1. 7.2. 7.3.	Esquema y fotografía del acelerómetro pendular diseñado y fabricado por la empresa Bosch Fotografía del llamado G-Chip desarrollado por al empresa Insouth Microsystems Fotografía del acelerómetro ADXL50 desarrollado y comercializado por la empresa Analog Devices Inc.	258 259 260
7.4.	Fotografía retocada de una celda G desarrollada por Motorola.	260 260
8.1. 8.2.	Suspensión formada a partir de vigas voladas sometidas a flexión lateral con restricciones de giro en su extremo adherido a la masa móvil	$273 \\ 274$

8.3.	Suspensión formada a partir de una viga volada doblada.	275
8.4.	Suspensión formada a partir de un par de vigas voladas dobladas y conectadas entre sí	276
8.5.	Suspensión tipo serpentin. Muy útil en microensambles.	277
8.6.	Suspensión tipo caja con bordes rectangulares.	278
8.7.	Suspensión de caja con bordes circulares.	279
8.8.	Suspensión sagital. Muy sensible pues puede amplificar un movimiento por factores mayores	
	a 10	280
8.9.	Suspensión en forma de doble V	281
8.10.	Suspensión tipo patas de cangrejo. Normalmente el segmento más largo se coloca de forma	
	ortogonal a la dirección de movimiento.	282
8.11.	Suspensión tipo langosta. Se utilizan cuatro, una en cada esquina, para sostener una placa	
	rectangular.	283
8.12.	Suspensión tipo X, este tipo de suspensión toma su nombre debido a que se colocan cuatro	
	soportes inclinados (dos por lado) para una placa (masa) móvil	284
8.13.	Suspensión en forma de espiral. La masa móvil se encuentra sujeta al centro de la espiral y se	
	presenta un par como entrada.	285
0.1		
9.1.	Modelo tridimensional del actuador y sensor electrostatico. Se aprecian las ancias de los elec-	
	trodos diferenciales fijos y las pistas de PolyU que sirven para la conexión elèctrica y corren	050
	por debajo de los electrodos (vigas) suspendidos	358